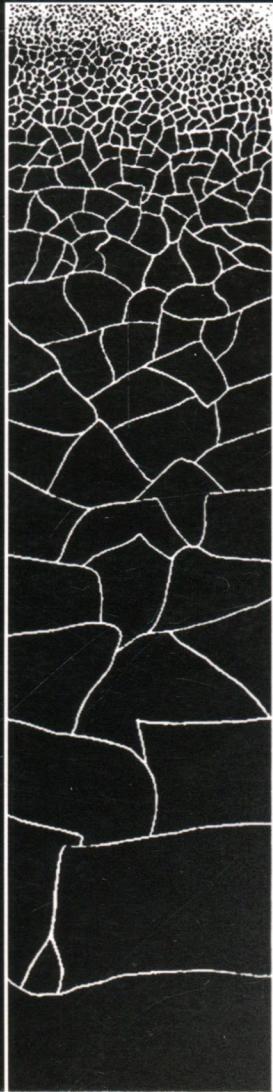


Г. М. Мокроусов, О. Н. Зарубина, Т. П. Бекезина

МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ



Г. М. МОКРОУСОВ,
О. Н. ЗАРУБИНА,
Т. П. БЕКЕЗИНА

МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В ЖИДКИХ СРЕДАХ

Учебное пособие



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · МОСКВА · КРАСНОДАР
2021

ББК 24.5я73

М 74

Мокроусов Г. М., Зарубина О. Н., Бекезина Т. П.

М 74 Межфазные превращения и формирование поверхности многокомпонентных полупроводников в жидких средах: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2021. — 112 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1872-5

В пособии на примере полупроводников типа $A^{III}B^V$ и $A^{II}B^{VI}$ рассмотрены типичные межфазные превращения (потенциалопределяющие реакции), протекающие в системах многокомпонентное соединение-вода (рН). При этом поверхность представлена в виде структуры, состоящей из поверхностного фазового слоя и приповерхностного кристаллического слоя, находящегося между поверхностным фазовым слоем (или при отсутствии такого — раствором) и объемом твердого тела. Данное пособие поможет моделировать границы раздела фаз сложных неорганических веществ и материалов, целенаправленно прогнозировать и создавать их межфазные границы с необходимым составом и строением путем различных (электро) химических операций, устранять или вводить дефекты в приповерхностные области кристаллических веществ, управлять свойствами структур типа П-М, П-Д и осуществлять наноструктурирование поверхности кристаллических материалов.

Пособие предназначено на студентов, обучающихся по направлениям «Химия», «Химия, физика и механика материалов», «Фундаментальная и прикладная химия», аспирантов, преподавателей химических вузов и факультетов, а также специалистов, работающих в области физикохимии полупроводников, формирования и модификации поверхности твердых тел для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур, а также в области материаловедения и технологии структур. Оно будет полезно специалистам, разрабатывающим и производящим различного рода (nano, микро, макро) структуры на основе полупроводников и металлов с использованием водных и неводных сред, а также при решении вопросов их стабильности, включая коррозионную стойкость.

ББК 24.5я73

Издаётся в авторской редакции

Рецензент

Т. С. МИНАКОВА — кандидат химических наук, доцент, профессор кафедры физической и коллоидной химии Томского государственного университета.

Обложка
E. A. ВЛАСОВА

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «Лань», 2021
© Коллектив авторов, 2021
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2021

Оглавление

Введение	5
Глава 1	
Теоретические основы методов формирования поверхности твердых тел	6
1.1 Процессы на границе простое вещество – H ₂ O (рН)	6
1.2 Термодинамика превращений на межфазной границе простое вещество – H ₂ O (рН)	10
1.2.1 Превращения на межфазной границе элементов III и V групп-H ₂ O (рН)	10
1.2.2 Превращения на межфазной границе элементов II и VI групп-H ₂ O (рН)	18
1.3 Превращения на межфазной границе водная среда (рН)-многокомпонентное вещество на примере соединений элементов II - VI и III - V групп	24
1.3.1 Превращения на межфазной границе полупроводник типа A ^{III} B ^V -H ₂ O (рН)	25
1.3.2 Превращения на межфазной границе полупроводник типа A ^{II} B ^{VI} -H ₂ O (рН)	32
1.4 Состав и строение межфазных границ полупроводников A ^{III} B ^V , формируемых различными методами	37
1.4.1 Граница объем твердого тела – поверхностный фазовый слой (или раствор)	38
1.4.2 Образование приповерхностного кристаллического слоя, находящегося между поверхностным фазовым слоем (или при отсутствии такого – раствором) и объемом кристалла; его состав, строение и протяженность.....	41
Глава 2	
Химические и электрохимические методы формирования поверхности твердых тел и полупроводниковых структур	45
2.1 Общие понятия о методах подготовки поверхности и типах травителей	45
2.2 Составы травителей для полировки поверхности и выявления дефектов кристаллической структуры полупроводников	48
2.3 Локальное анизотропное травление полупроводников.....	51
2.3.1 Общие сведения, термины	52
2.3.2 Боковое подтравливание и форма фигур травления	56
2.3.3 Профиль и огранка канавок при анизотропном травлении	58
2.3.4 Угловое подтравливание и способы его уменьшения	61
2.3.5 Составы анизотропных травителей и их применение для локального анизотропного травления в технологии микроэлектроники	65
2.4 Электрохимические методы формирования структур полупроводник-металл, полупроводник – диэлектрик	77
2.4.1 Основные понятия кинетики электродных процессов. Предмет и значение кинетики электродных процессов	77
2.4.2 Электрохимическое осаждение металлов	83
2.4.3 Электроосаждение металлов и сплавов на полупроводники	85
2.4.4 Анодное растворение и пассивность металлов.....	87
2.4.5 Анодирование металлов и полупроводников	90
Глава 3	
Описание практических занятий.....	94
3.1 Основные темы и вопросы для проведения расчетных семинарских занятий. Задачи для самостоятельной работы	94

3.2 Основные темы и краткое описание практических занятий по подготовке поверхности полупроводников и получения структур.....	95
3.2.1 Локальное анизотропное травление полупроводников	95
3.2.2 Полириующее травление полупроводников и выявление дислокаций	96
3.2.3 Электрохимическое осаждение металлов и структуры полупроводник–металл	97
3.2.4 Электрохимическая пассивация и оксидирование полупроводников, структуры полупроводник–диэлектрик.....	101
3.3 Вопросы для самоконтроля	104
Литература	105